

高速接地插头

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?QTS

绝缘体材料:

液晶

聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 的镍上

镀金或锡

额定电流:

触点: 30°C 温升时为 1.1A

接地板: 30°C 温升时为 7.8A

工作温度:

-55°C 至 +125°C

额定电压:

285 VAC

最大配接次数:

100

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0.10mm) .004" 最大 (025-075)

(0.15mm) .006" 最大 (100)

电路板相叠:

有关每块电路板需要两个连接器

或 100 个位置或更多位置的应用,

请联系 ipg@samtec.com



FILE NO. E111594

电路板配接:

QSS

缆线配接:

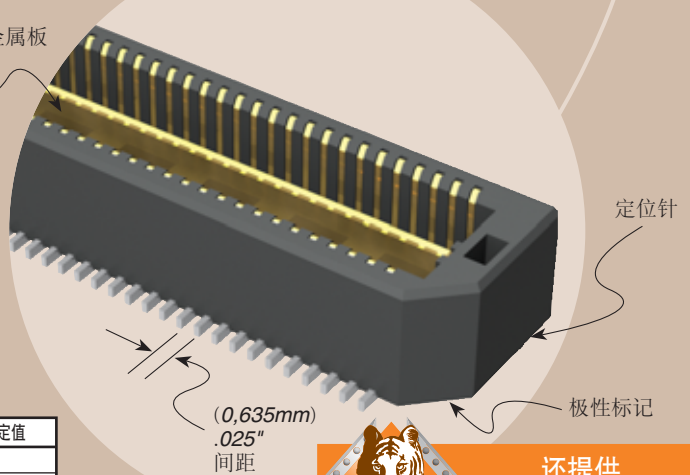
SQCD



5mm 堆叠高度	类型	在 3dB 插入损耗的额定值
单端信号	-D	9 GHz / 18 Gbps
差分对信号	-D	8.5 GHz / 17 Gbps
差分对信号	-DP	8.5 GHz / 17 Gbps

如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?QTS 或联系 sig@samtec.com

一体式
电源或接地金属板



定位针

极性标记



还提供

• 电路板间隔支架
(请参见 SO 系列)

QTS

每排
位置数

引线
式样

电镀选项

D

A

其他选项

-025, -050, -075, -100
(每列总共 50 个位置)

从
图表中
指定
引线
式样。

-F
= 信号引脚
和接地板镀金膜,
焊尾镀雾锡

-L
= 信号引脚和接地板上镀 10μ"
(0.25μm) 的金,
焊尾镀雾锡

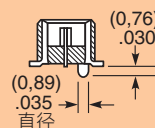
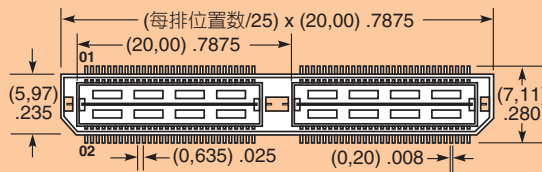
-C*
= 可选电镀
在触点区域的信号引脚上镀 150μ"
(3.81μm) 镍, 之上镀最少 50μ"
(1.27μm) 金、在触点区域的接地板
上镀 50μ" (1.27μm) 镍, 之上镀最
少 10μ" (0.25μm) 金,
在所有焊尾上镀最少 50μ"
(1.27μm) 镍, 之上镀雾锡

-K
= (7.00mm)
.275" 直径的聚酰亚
胺膜取
放垫

-TR
= 卷带封装
(-075 最大位置数)

特殊应用选项

- 11mm 和 16mm 堆叠高度 (小心: 有些自动放置/插入机械可能有元件高度限制。请参考机械技术规格。)
 - 30μ" (0.76μm) 金
 - 提供差分对和“可拆分” (在同一连接器中组合差分与单端列)。
 - 每排 125 个位置
 - 边缘封装
- 请致电 Samtec。



引线式样	堆叠高度 A	配接高度
-01	(4,27) .168	(5,00) .197
-02	(7,26) .286	(8,00) .315

加工条件将影响配接高度。

*注: -C 电镀通过
10 年 MFG 测试

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。